

2022年3月期

第2四半期決算説明

2021年11月5日

芝浦メカトロニクス株式会社

目次

- 1. 2022年3月期 第2四半期業績**
- 2. 2022年3月期 業績予想**
- 3. 中期経営計画の進捗**

業績結果 (対前年)

【連結】

単位：億円

	20/上	20/下	21/上 実績	対前年 増減率
売上高	233	215	219	▲6%
営業利益	16.5	13.1	18.5	+12%
R O S	7.0%	6.1%	8.4%	+1.4pt
経常利益	15.8	12.4	17.5	+10%
特別損失	-	-	6.1	-
当期純利益	11.4	8.3	7.5	▲34%
受注高	182	238	293	+61%

業績結果まとめ (対前年) ①

* SPE : 半導体前・後工程装置
FPD : FPD前・後工程装置

- 売上高 前年比6%減収 (233億円 ⇒ 219億円)
 - SPE分野は増加だが、FPD分野が減少のため、全体として減収
- 営業利益 前年比12%増益 (16.5億円 ⇒ 18.5億円)
 - SPE分野の売上増加により、営業利益は増益
- 当期純利益 前年比34%減益 (11.4億円 ⇒ 7.5億円)
 - 5/13に公表した横浜事業所再開発に伴う特別損失 (6.1億円) を計上
- 受注高 前年比61%増加 (182億円 ⇒ 293億円)
 - SPE分野が順調に推移し、FPD分野も堅調に推移して、大幅増

業績結果まとめ（対前年）②

■ ファインメカトロニクス部門

* ファインメカトロニクス部門：半導体/FPD前工程装置

➤ 売上高 前年比14%減（160億円 ⇒ 137億円）

半導体前工程では、ロジック/ファウンドリ向けやウェーハ向け、パワーデバイス向けが堅調で増加。

FPD前工程では、前年度受注低調の影響などにより減少。

➤ セグメント利益 前年比34%減（13.6億円 ⇒ 9.0億円）

半導体前工程が売上増加で増益だが、FPD前工程の売上減少などから全体として減益。

➤ 受注高 前年比50%増（125億円 ⇒ 187億円）

半導体前工程では、ウェーハ向けやパワーデバイス向けを中心に好調に推移。

FPD前工程では、中小型パネル向けが堅調に推移。

業績結果まとめ（対前年）③

■ メカトロニクスシステム部門

*メカトロニクスシステム部門：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

➤ 売上高 前年比12%増（56億円 ⇒ 62億円）

半導体後工程では、2.5Dなど先端パッケージ向けやFO-PLP向け、ディスプレイドライバIC向けが全体として好調で増加。

FPD後工程では、大型パネル向け装置は堅調であったものの、一部顧客の投資計画後ろ倒しの影響により減少。

➤ セグメント利益 前年比225%増（2.8億円 ⇒ 9.3億円）

半導体後工程の売上増加が大きく寄与し増益。

➤ 受注高 前年比114%増（40億円 ⇒ 87億円）

半導体後工程では、全般的に好調に推移。

FPD後工程では、大型パネル向けが後ろ倒しとなっていた顧客の投資計画が再開されたことなどにより堅調に推移。

業績結果 (対前回予想)

【連結】

*1: 2021年5月公表
単位：億円

	21/上		
	前回予想 *1	実績	対前回予想 増減率
売上高	230	219	▲5%
営業利益	17.0	18.5	+9%
R O S	7.4%	8.4%	+1.0pt
経常利益	16.0	17.5	+9%
特別損失	6.1	6.1	-
当期純利益	5.0	7.5	+50%
受注高	-	293	-

業績結果まとめ (対前回予想)

- 売上高 前回予想比5%減収 (230億円 ⇒ 219億円)
 - SPE分野は堅調であったが、FPD分野が顧客投資計画の後ろ倒しで減少し、全体として減収

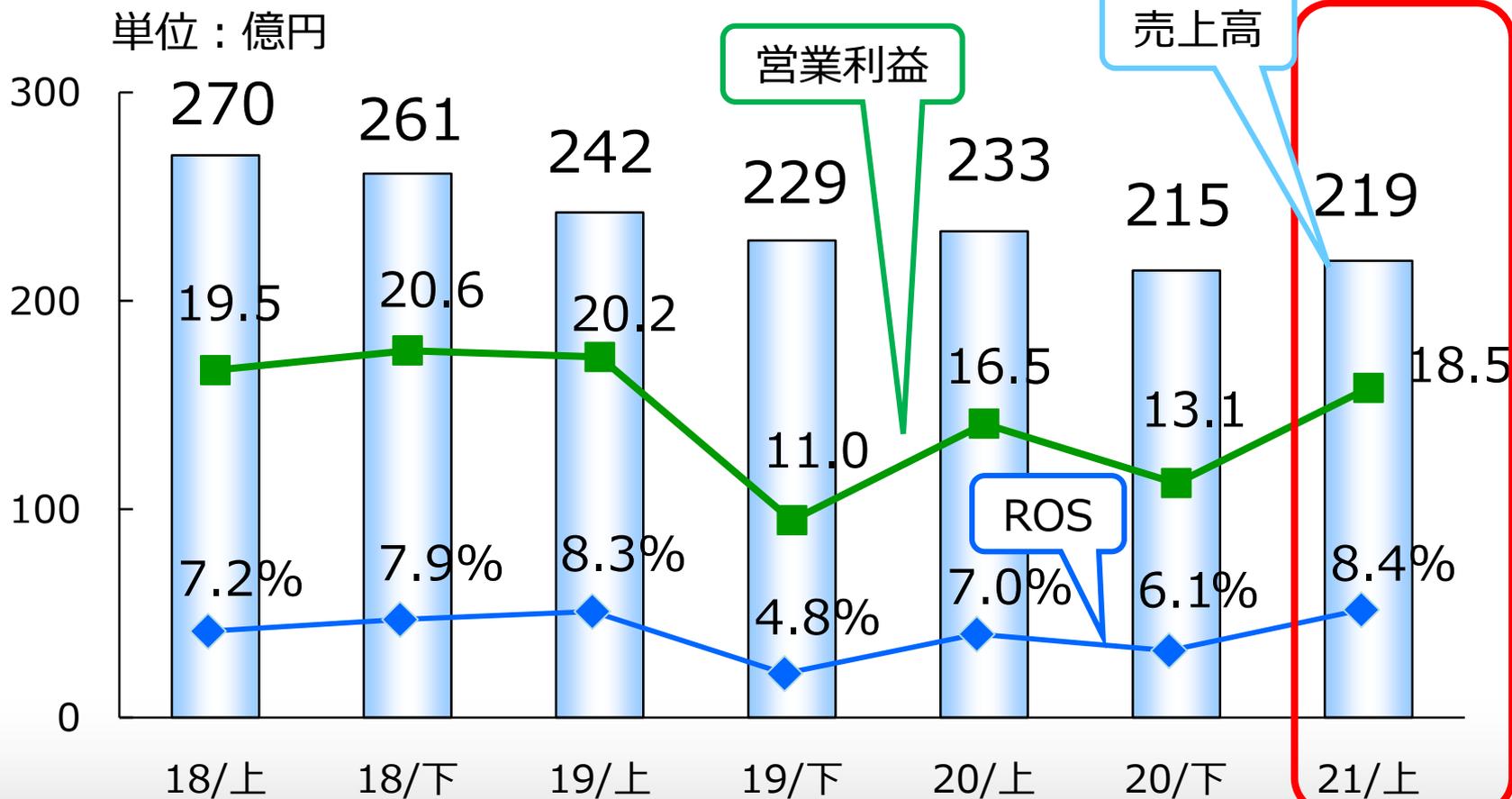
- 営業利益 前回予想比9%増益 (17.0億円 ⇒ 18.5億円)
 - SPE分野の比率増加による利益率改善、経費抑制により改善

- 当期純利益 前年予想比50%増益 (5.0億円 ⇒ 7.5億円)
 - 営業利益改善と税負担軽減等により改善

売上高・利益・ROS

SPE分野が増加しROS改善

【連結】



セグメント別売上高

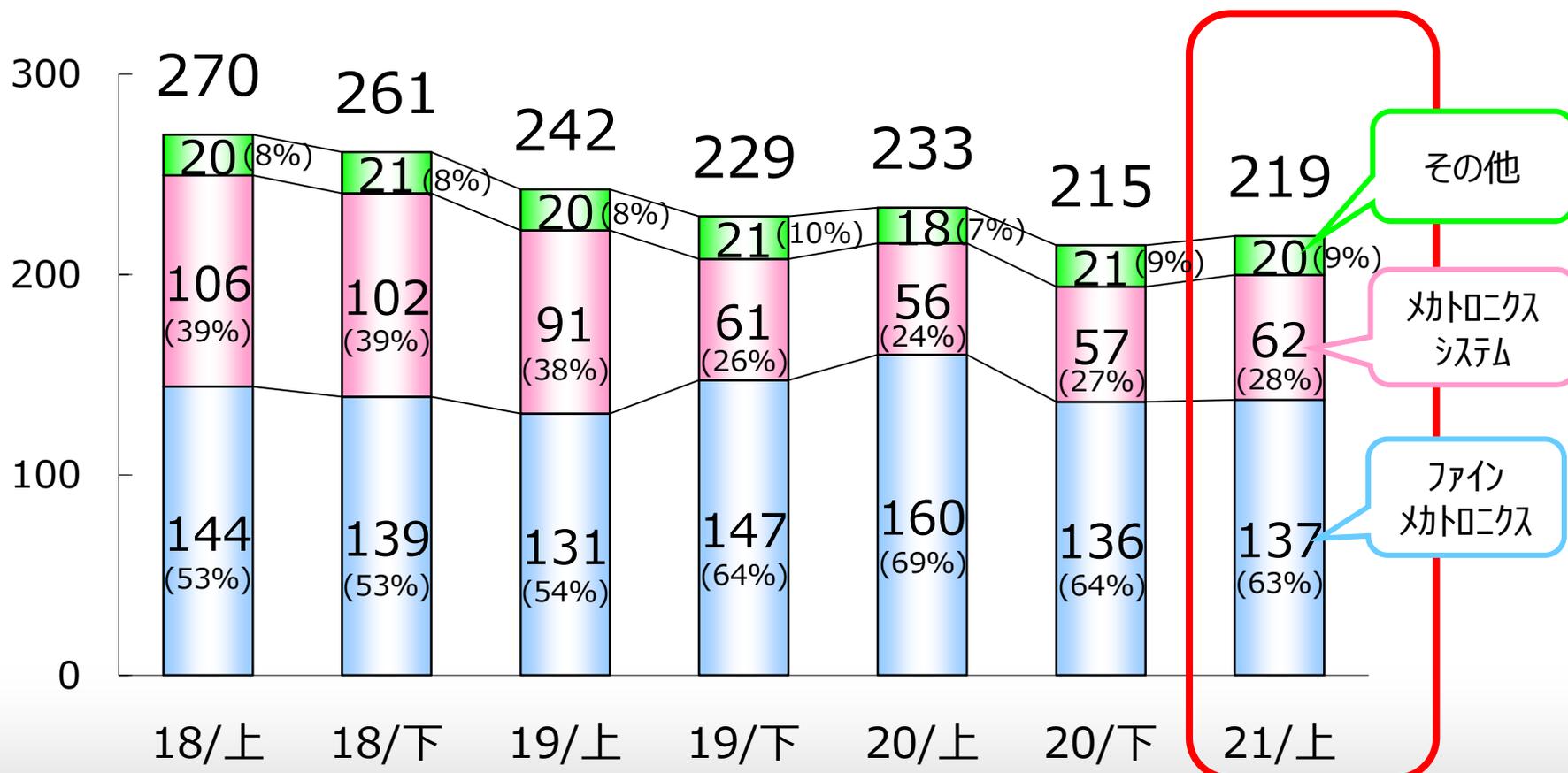
ファインメカトロニクスが60%台で推移

【連結】

単位：億円

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置

メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置



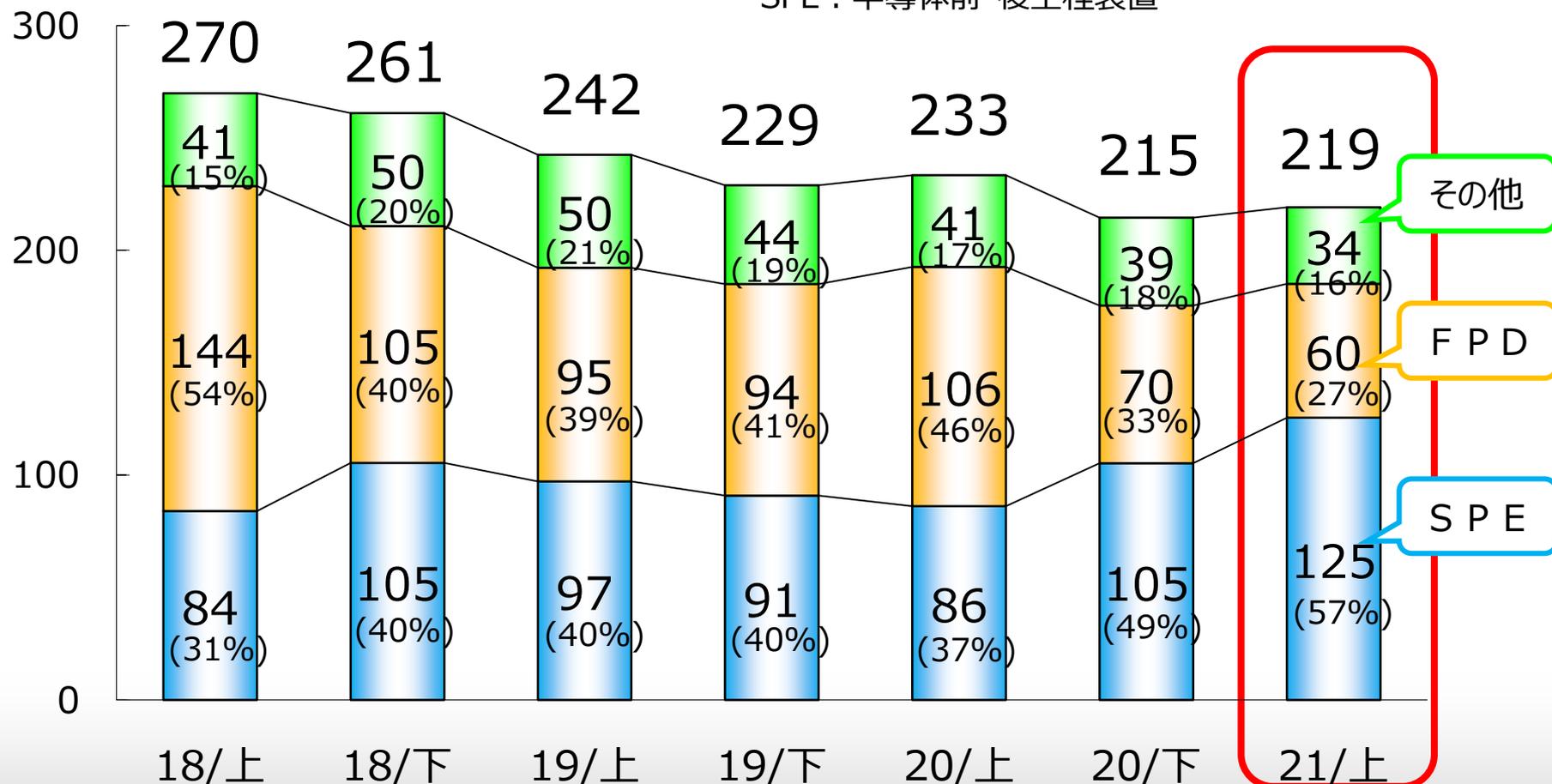
分野別売上高

SPE分野が57%に増加

【連結】 単位：億円

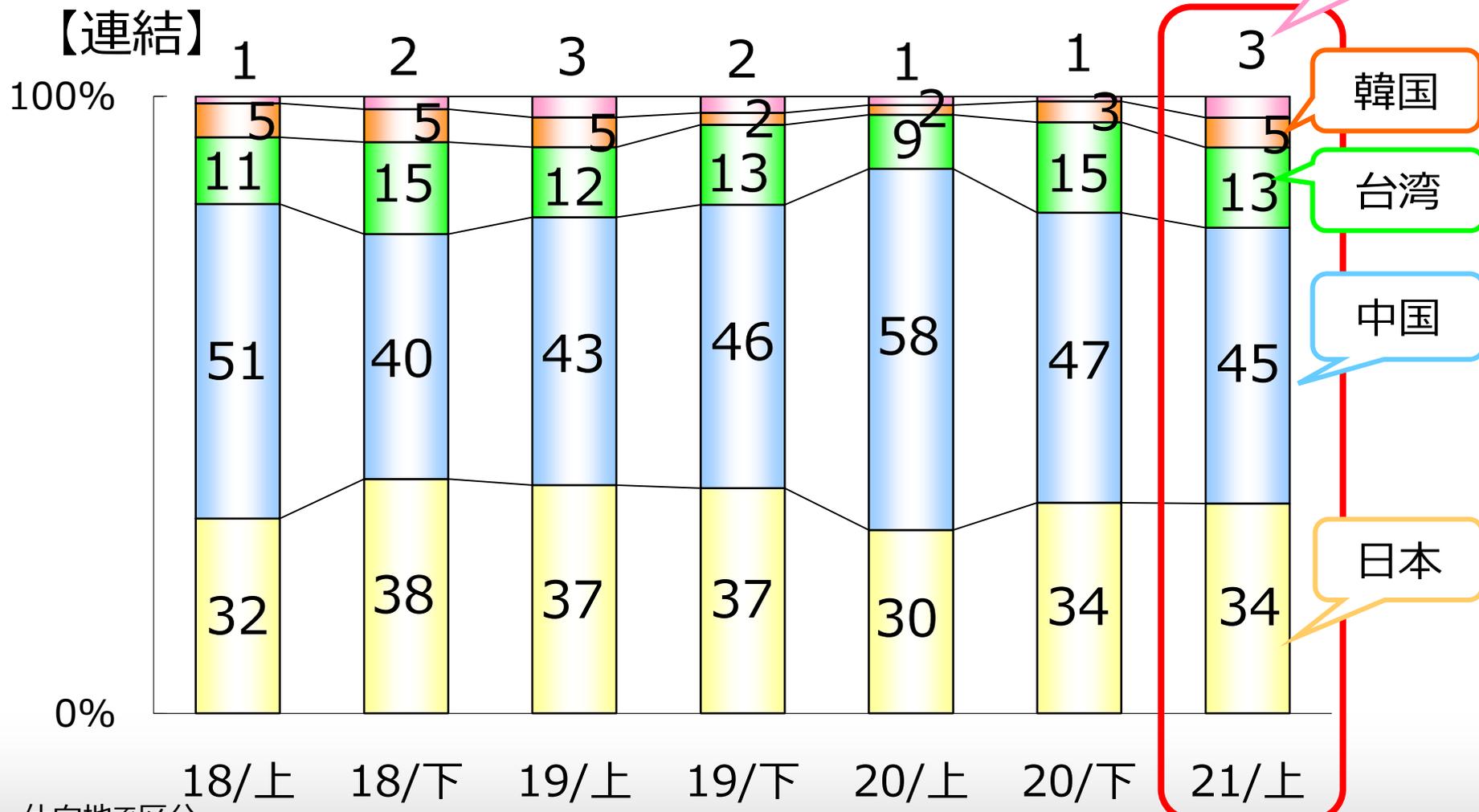
* FPD：FPD前・後工程装置

SPE：半導体前・後工程装置



地域別売上高比率

海外向け66% (中国45%)



* 仕向地で区分

セグメント別受注高

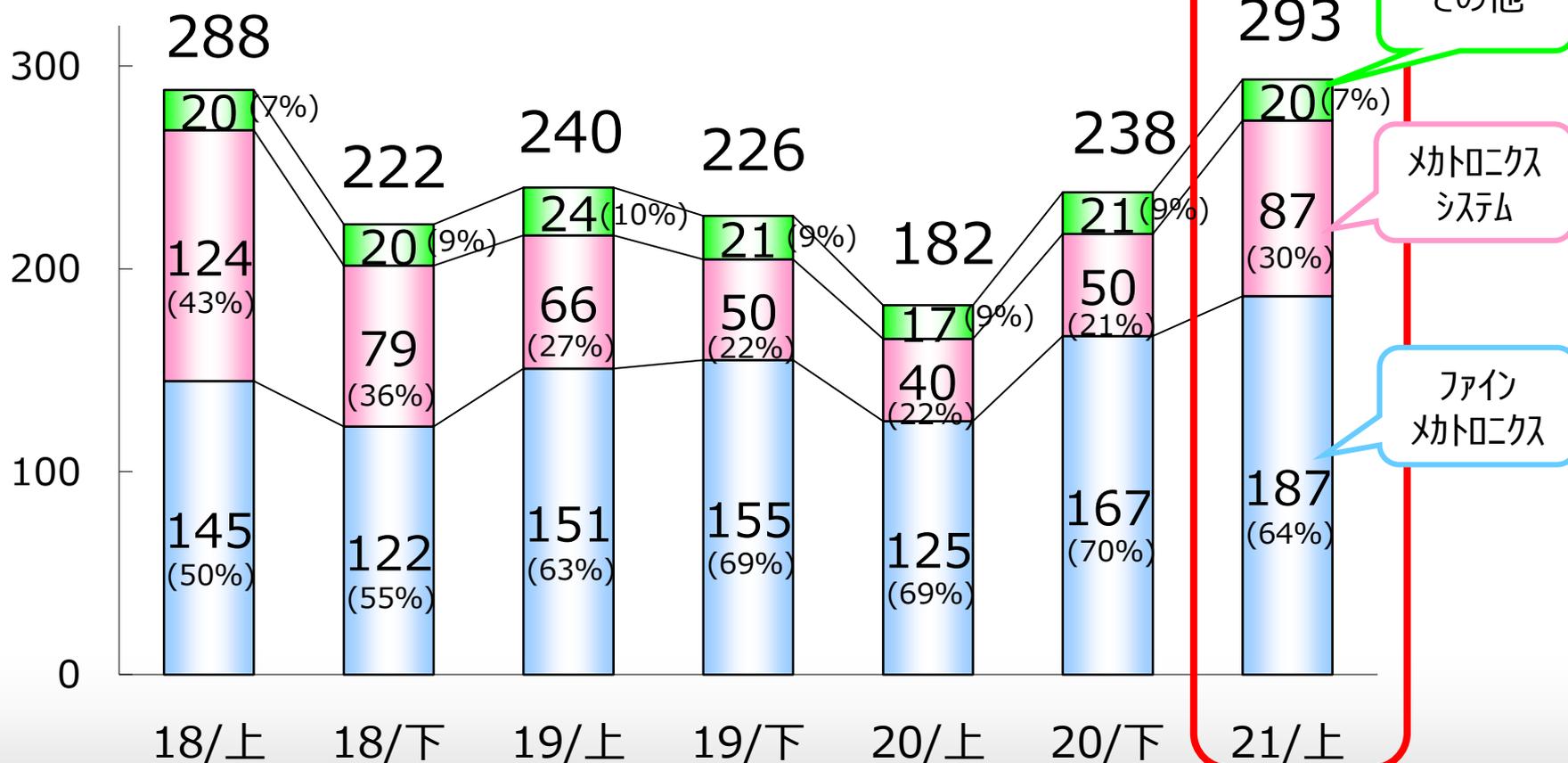
20/上を底に順調に増加

【連結】

* ファインメトロクス：半導体/FPD前工程装置

メトロクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

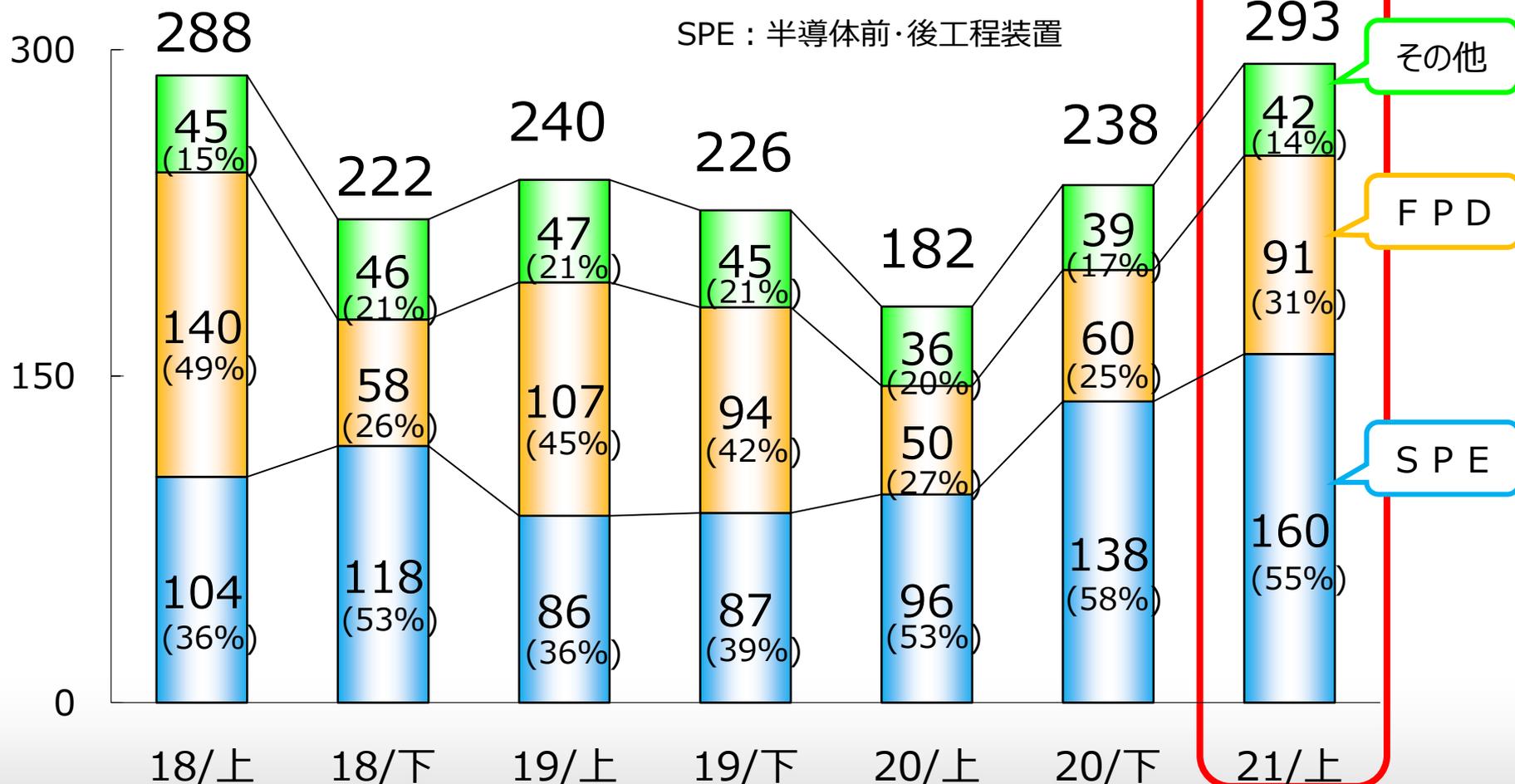
単位：億円



分野別受注高

SPE分野が牽引し全体に順調に増加

【連結】 単位：億円

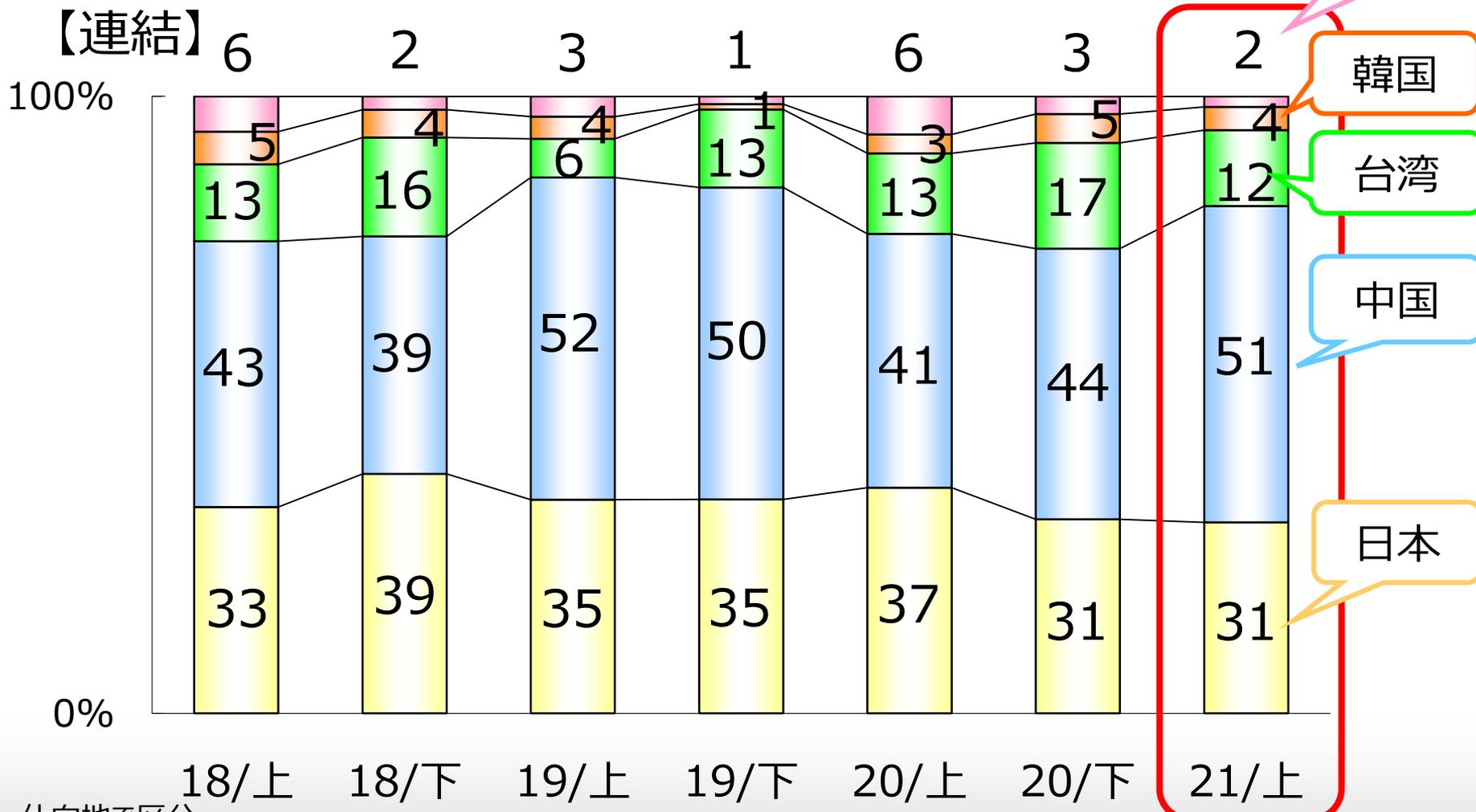


* FPD：FPD前・後工程装置

SPE：半導体前・後工程装置

地域別受注高比率

海外向け69% (中国51%)

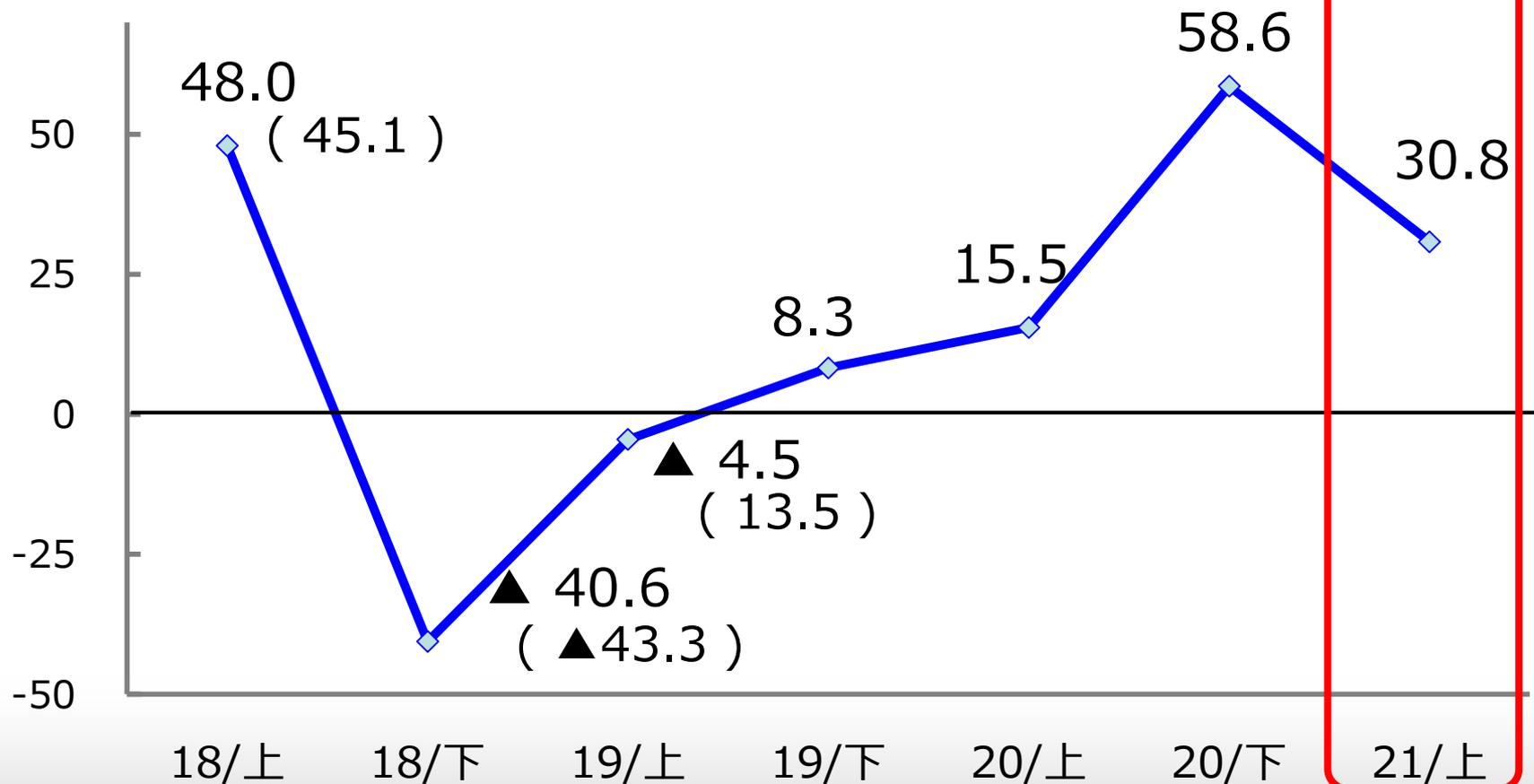


* 仕向地で区分

フリーキャッシュ・フロー

【連結】 単位：億円

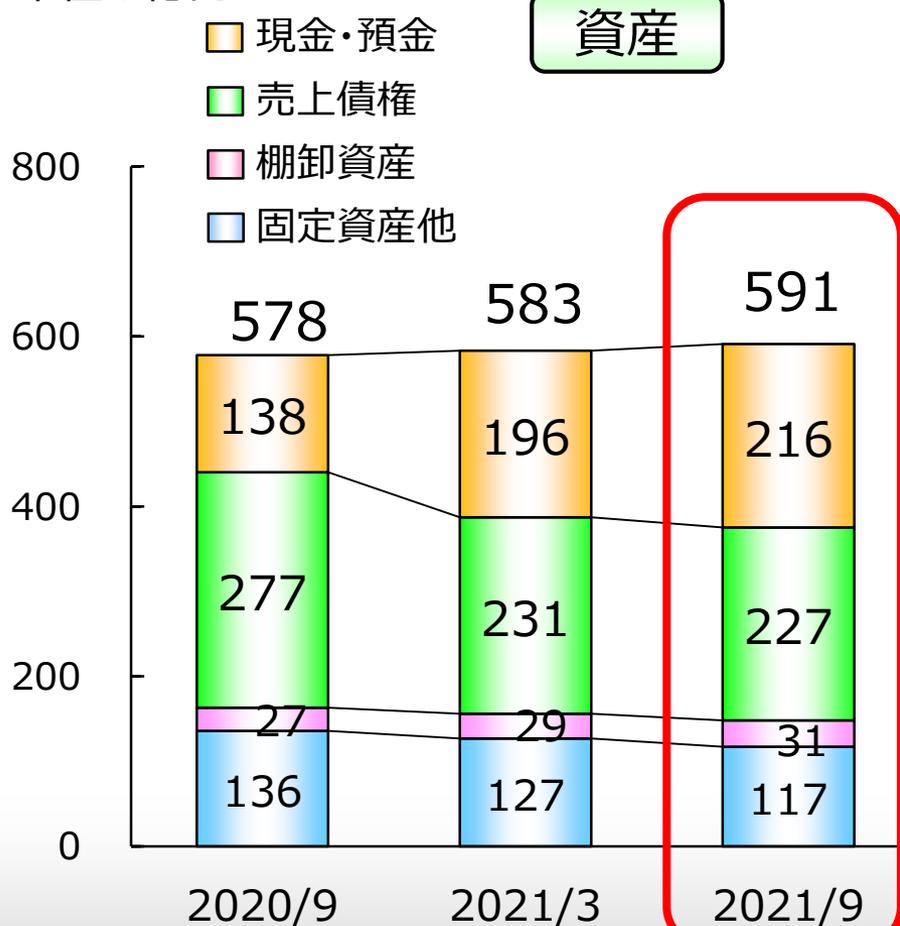
* () 内：期末日休日の影響を除いた
実質フリーキャッシュ・フロー



貸借対照表

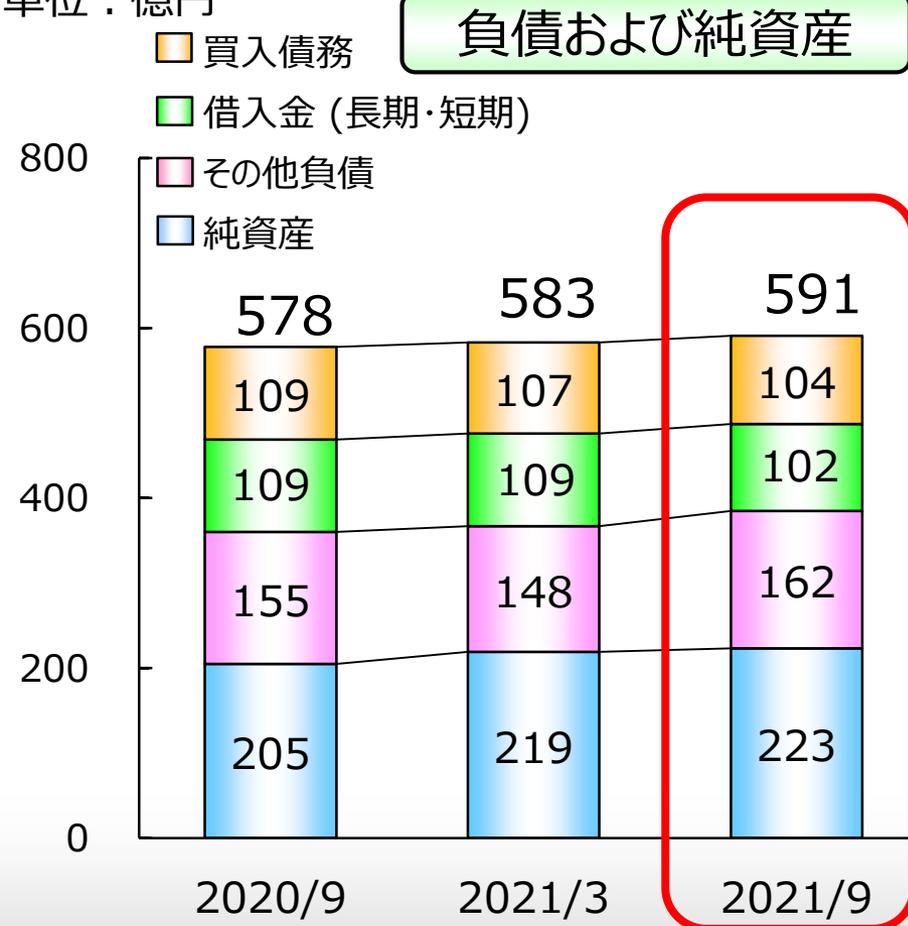
【連結】

単位：億円



自己資本比率 '21/3 37% → '21/9 38%
D/Eレシオ '21/3 50% → '21/9 46%

単位：億円



目次

1. 2022年3月期 第2四半期業績
- 2. 2022年3月期 業績予想**
3. 中期経営計画の進捗

業績予想

【連結】

前回予想から売上高変更なし、
利益は上回る見込み

*1: 2021年5月公表
単位：億円

	2020年度			2021年度		2021年度 予想	前回予想 *1		2021年度
	20/上	20/下	2020年度	21/上 実績	21/下 予想		21/上	21/下	
売上高	233	215	448	219	261	480	230	250	480
営業利益	16.5	13.1	29.6	18.5	24.0	42.5	17.0	23.0	40.0
R O S	7.0%	6.1%	6.6%	8.4%	9.2%	8.9%	7.4%	9.2%	8.3%
経常利益	15.8	12.4	28.2	17.5	23.0	40.5	16.0	22.0	38.0
特別損失	-	-	-	6.1	-	6.1	6.1	-	6.1
当期純利益	11.4	8.3	19.7	7.5	17.5	25.0	5.0	16.0	21.0
R O E	-	-	9.5%	-	-	11.0%	-	-	9.2%
配当	-	-	110円	-	-	200円	-	-	170円

配当予想

2021年度 業績予想の上方修正に伴い、期末配当は、30円増配の200円としました。

当社は、配当性向（連結純利益）25%～30%を目途としており、今回の配当予想は、特別損失反映前の連結配当性向を加味しております。

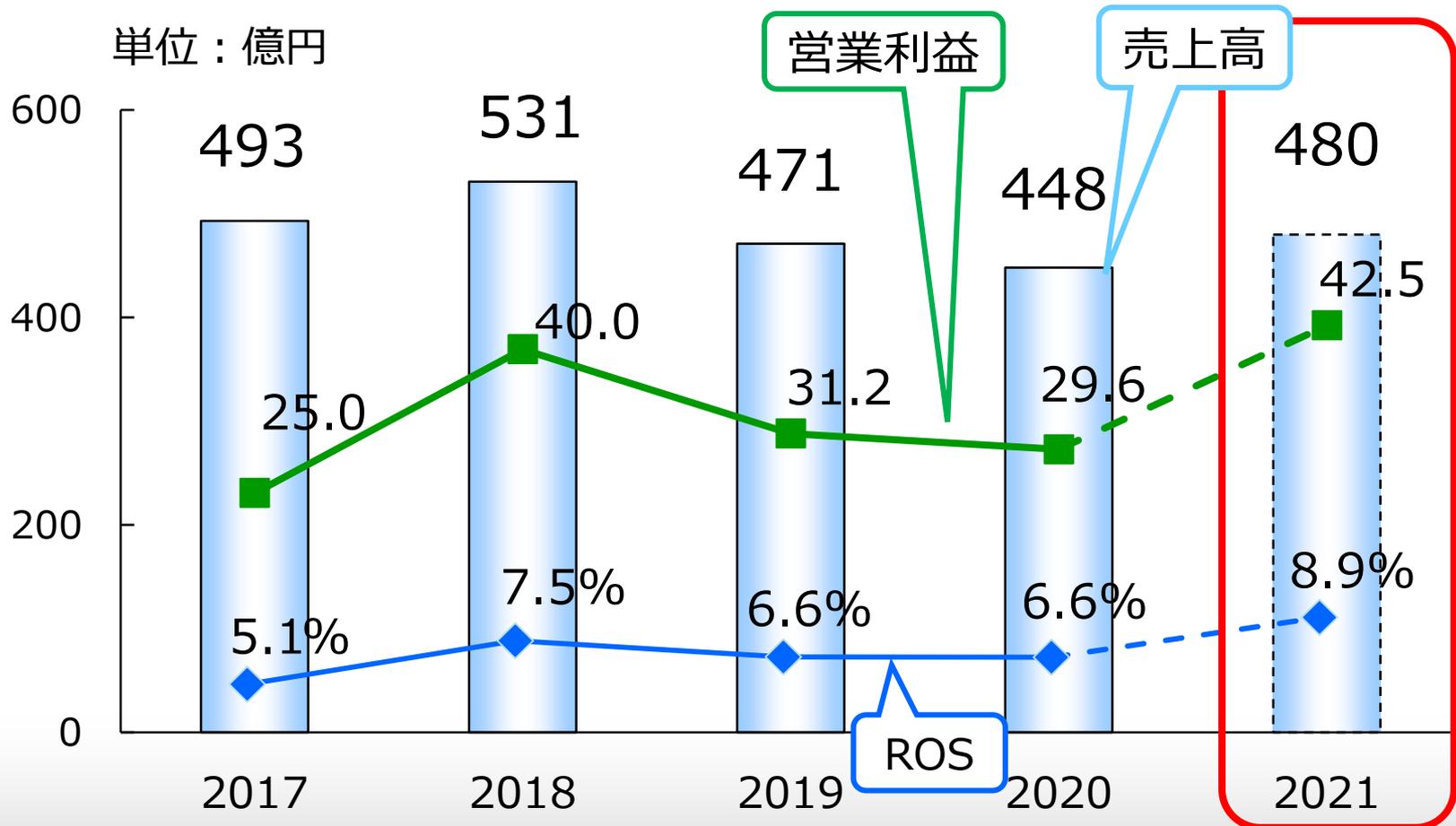
	第2四半期末 配当	期末配当	年間配当
今回予想（2022年3月期）	0円	200円	200円
前回予想（2022年3月期）	0円	170円	170円

売上高・利益・ROS

増収増益基調へ

【連結】

単位：億円



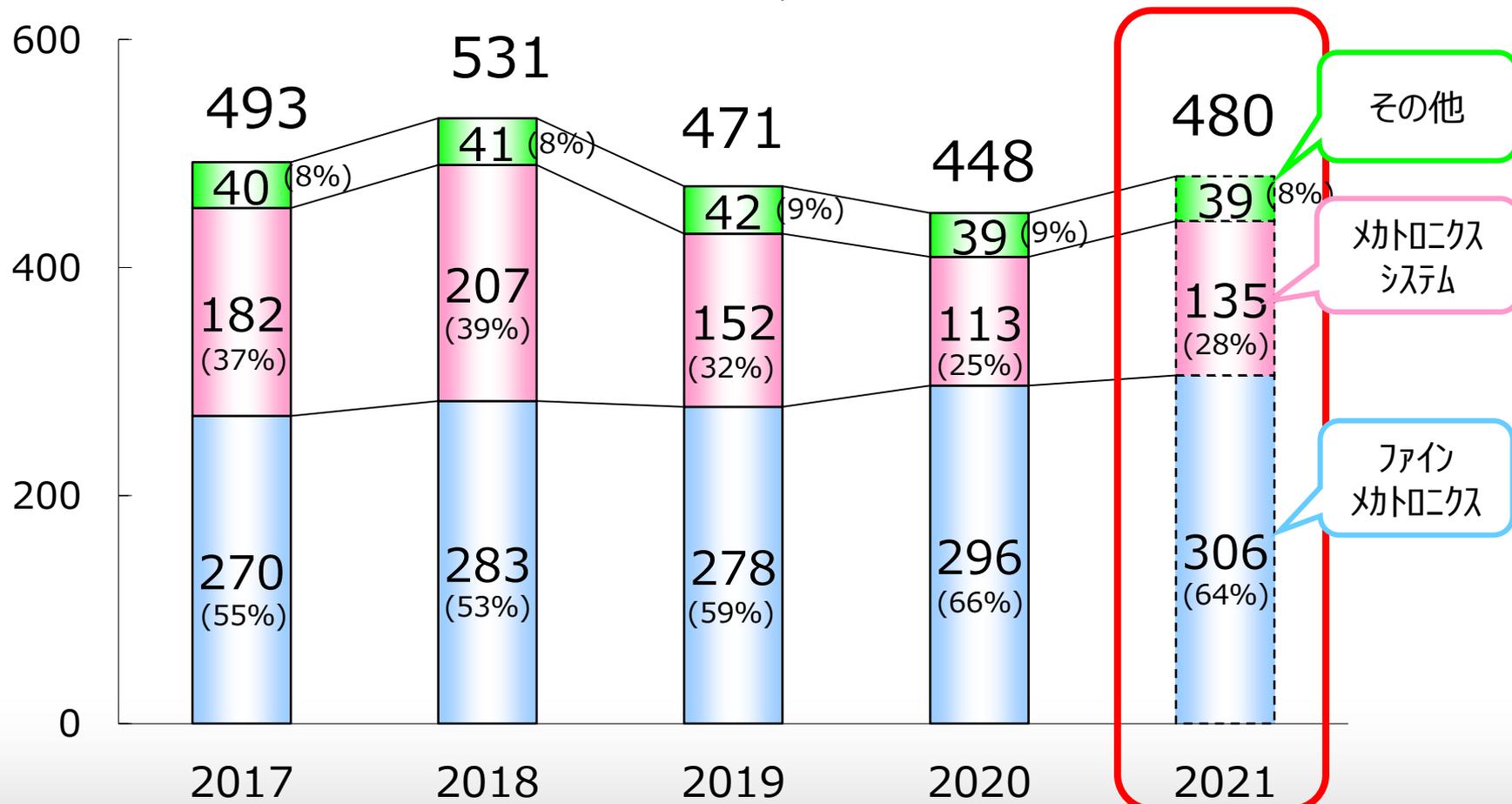
セグメント別売上高

ファインメカトロニクスが64%

【連結】 単位：億円

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置

メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

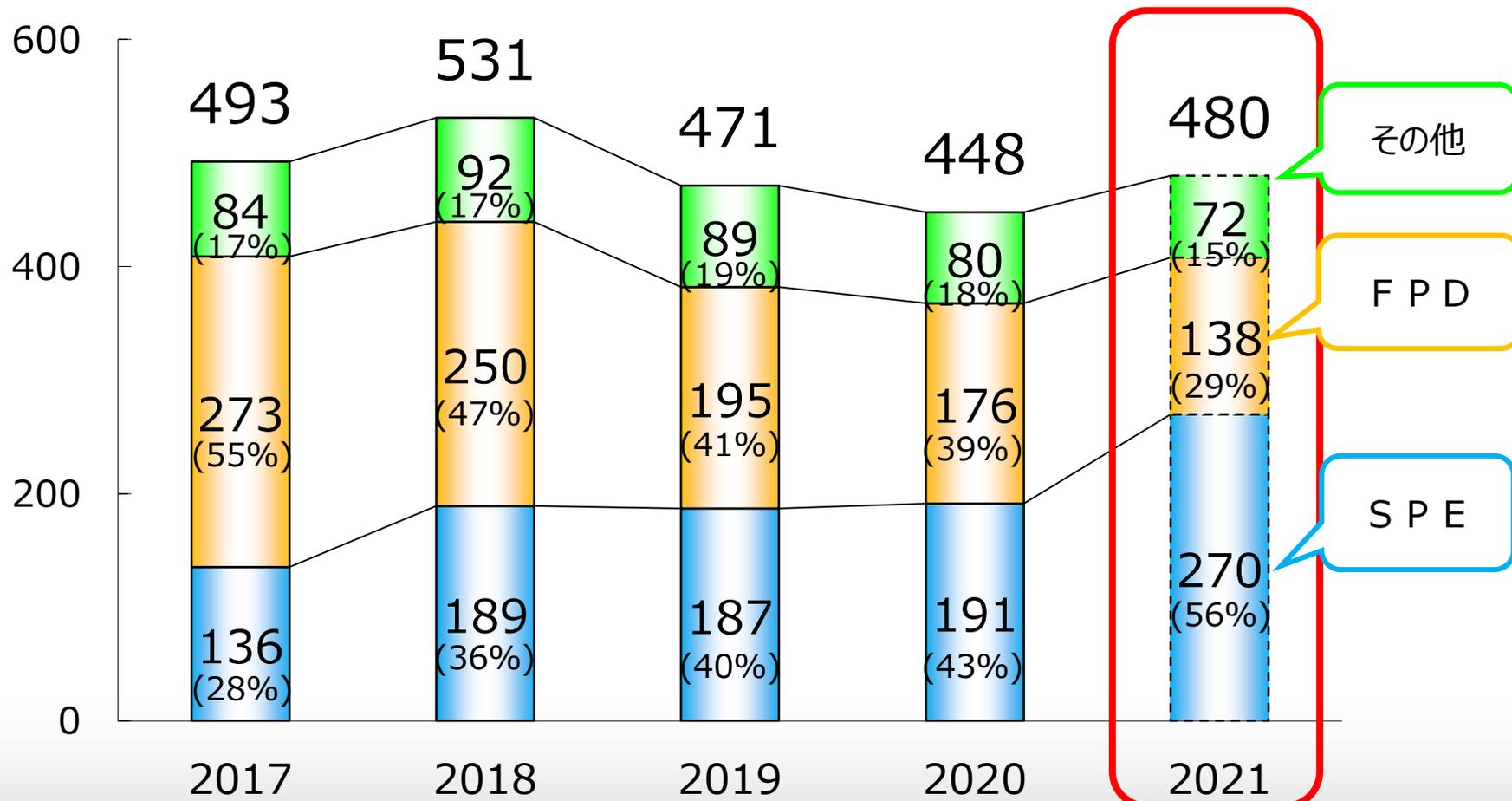


分野別売上高

SPE分野が56%

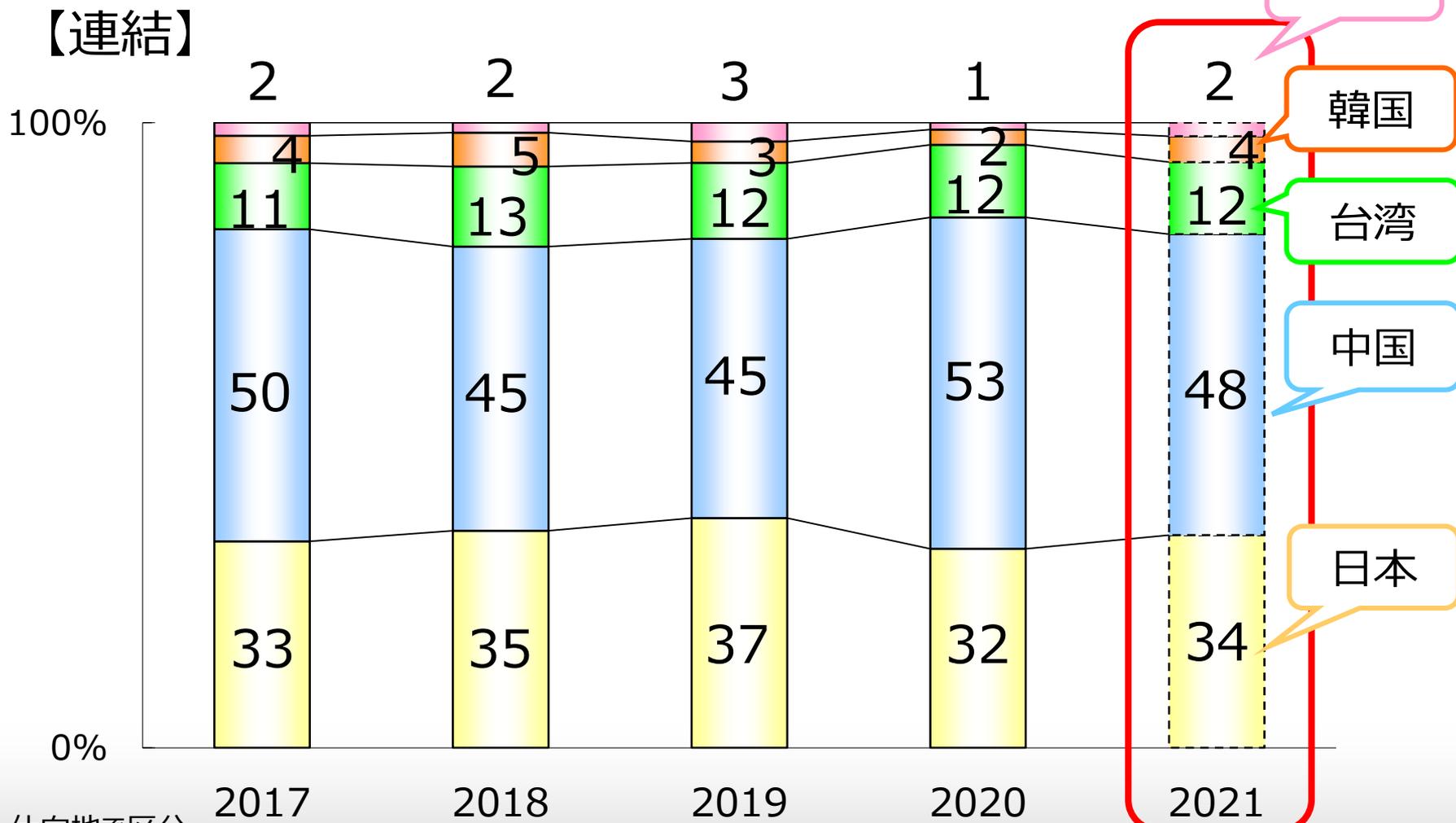
* SPE : 半導体前・後工程装置
FPD : FPD前・後工程装置

【連結】 単位：億円



地域別売上高比率

海外向け66% (中国48%)



* 仕向地で区分

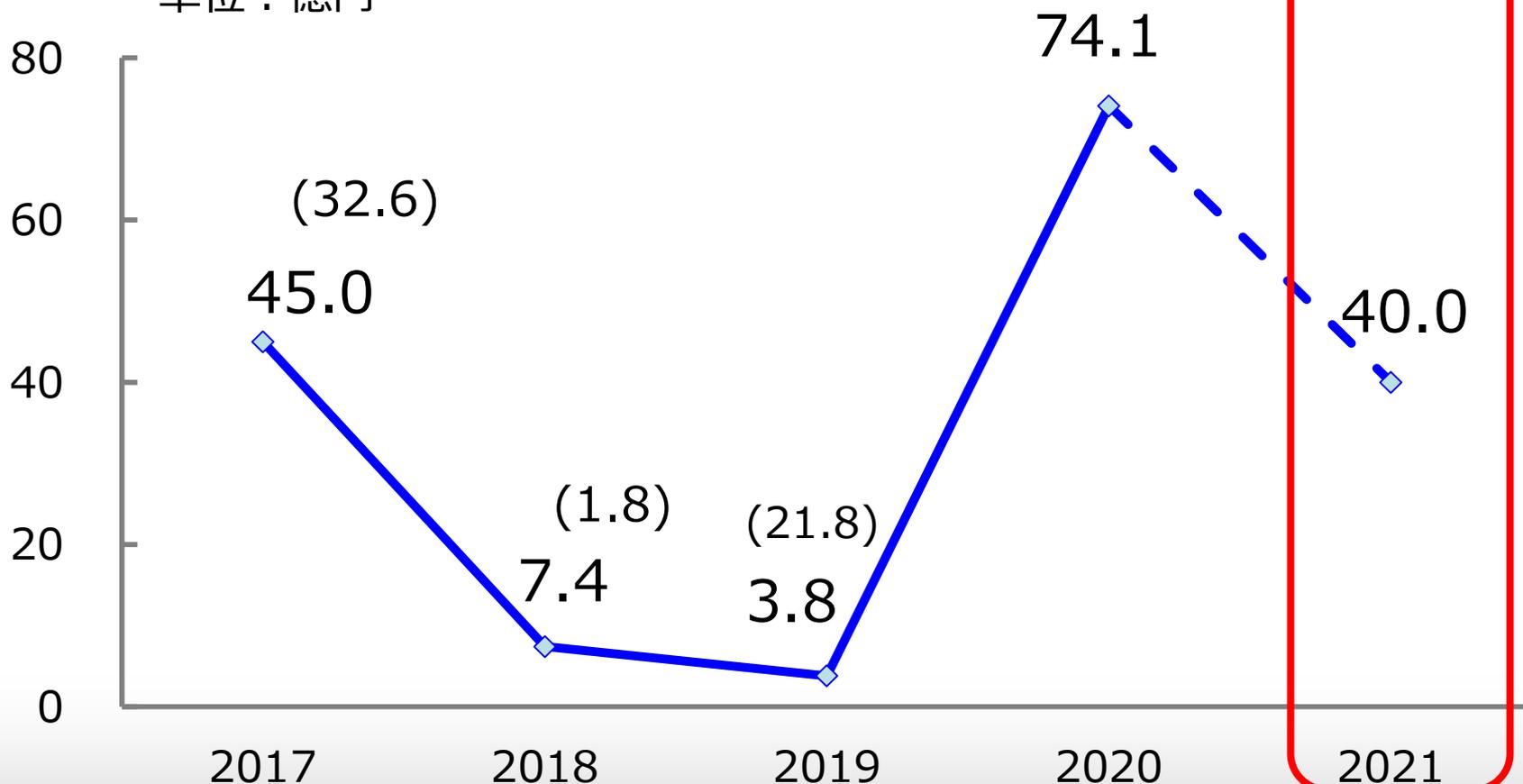
フリーキャッシュ・フロー

前回予想 19.0 → 今回予想 40.0

【連結】

単位：億円

* () 内：期末日休日の影響を除いた
実質フリーキャッシュ・フロー



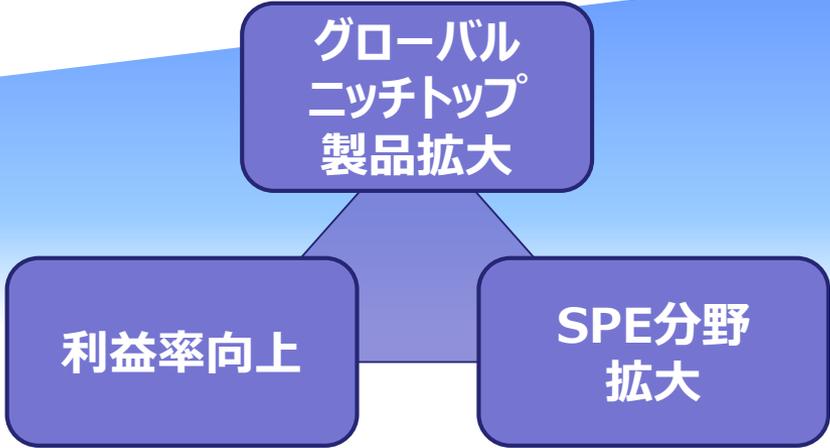
目次

1. 2022年3月期 第2四半期業績
2. 2022年3月期 業績予想
- 3. 中期経営計画の進捗**

中期経営計画方針



SPE



FPD

これからのありたい姿

- ◆ IoT、5G、AIと、これから更に広がるデータ社会に向けて、半導体・FPD製造装置を通じた先端技術で貢献 ～「ものづくり」から「価値づくり」～
- ◆ SPE分野でグローバルニッチトップ、FPD分野で主要サプライヤとして存在感を示せる企業グループへと成長

中期経営計画の進捗

2021年度は中計目標の
売上・利益達成見込み

*1: 2021年5月公表

*2: 2020年11月公表

単位：億円

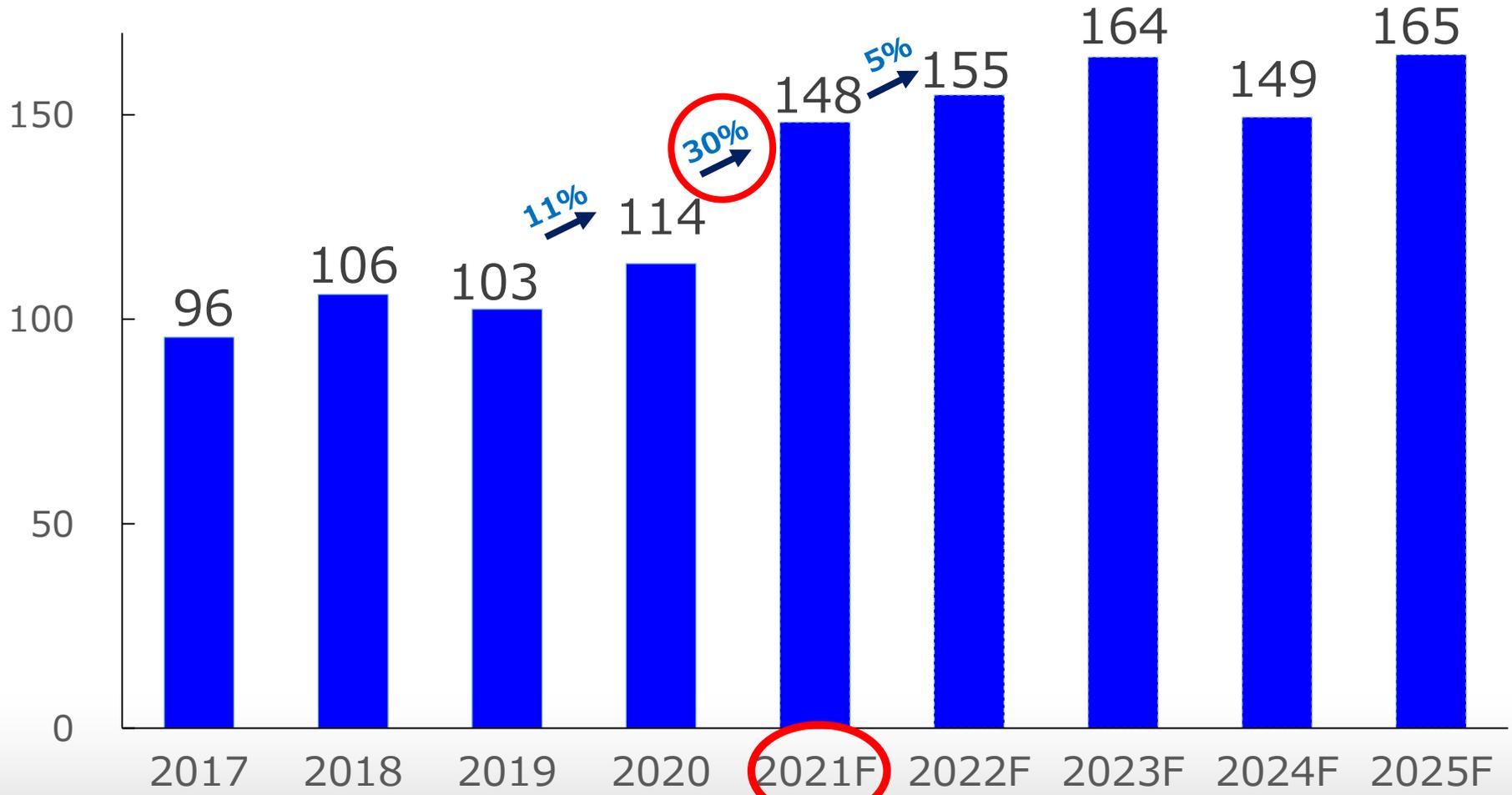
	2020	2021	2021	中期経営計画年度目標 *2		
	年度実績	年度予想	年度予想 *1	2020	2021	2022
売上高	448	480	480	460	480	510
営業利益	29.6	42.5	40.0	30.0	38.5	51.0
R O S	6.6%	8.9%	8.3%	6.5%	8.0%	10.0%
経常利益	28.2	40.5	38.0	-	-	-
当期純利益	19.7	25.0	21.0	-	-	-
R O E	9.5%	11.0%	9.2%	9.5%	11.5%	13.0%

半導体工場・設備 投資高予測

* 出典：IC Insights 2021-7
当社にてグラフ作成

単位：10億US \$

2019 – 2022 CAGR : 14.8%



当社の事業環境

- IoT、5G、AIの発展で設備投資の拡大が期待される
現在の当社の事業環境は、受注面からみると
 - ✓ 半導体前工程 ロジック/ファウンドリ、メモリ、ウェーハ、パワーデバイス、いずれも投資継続、市場拡大
 - ✓ 半導体後工程 2.5D等先端パッケージ市場堅調、新技術フュージョン接合への期待上昇、FO-PLP関連で市場拡大

当中期経営計画グローバル ニッチトップ対象製品群

工程	対象装置	主な対象製品等
Siウェーハ製造	枚葉式洗浄装置	300mmウェーハ (プライム、再生)
フォトマスク製造	・エッチング装置 ・枚葉式洗浄装置	ブランクス、PSM、EUVマスク、 次世代EUVマスク
ウェーハプロセス	枚葉式リン酸エッチング装置	ロジック/ファウンドリ
モジュールプロセス	高精度フリップチップボンダ	FO-WLP/PLP、2.5D、 CoWフュージョンボンディング

トピックス1

トピックス2

その他注目製品

工程	対象装置	主な対象製品等
ウェーハプロセス	ケミカルドライエッチング装置	パワーデバイス CMOSイメージセンサ

トピックス1

Siウェーハ製造／ウェーハプロセス事例

GNT

当中期経営計画
グローバル ニッチトップ
対象製品群

GNT



枚葉式Siウェーハ洗浄装置
(SC300 Series)

<特徴>

- ・枚葉式による高潔浄度対応
- ・マルチチャンバ化による高生産性対応
- ・CMP装置との豊富なインライン接続実績

<展開>

- ・枚葉式ウェーハ洗浄で世界シェアNo.1
- ・大手メーカーや新興国向け採用増で受注好調



ケミカルドライエッチング装置
(CDE Series CDE-80,300)

<特徴>

- ・等方性ケミカルドライエッチング
- ・リモートプラズマによるプラズマダメージフリーエッチング
- ・ウェーハ温度コントロールによるエッチングレートの高精密制御

<展開>

- ・パワーデバイス向け投資で堅調に受注推移
- ・適用工程拡大
- ・次世代材料(SiC、GaN)エッチング技術開発を積極推進

モジュールプロセス – 高精度フリップチップボンダ事例

GNT

先端パッケージボンダ
(TFC-6500)

<特徴>

- ・2.5D最先端パッケージ用途
- ・高精度
- ・高クリーン

<展開>

- ・デバイスメーカ、大手ファウンドリ、OSAT等で採用続伸
- ・車載関連、シリコンフォトリソグラフィ分野などで需要拡大

GNT

フュージョンボンダ
(TFC-6700)

<特徴>

- ・CoWに対応するフュージョンボンダ
- ・超高精度
- ・高クリーン

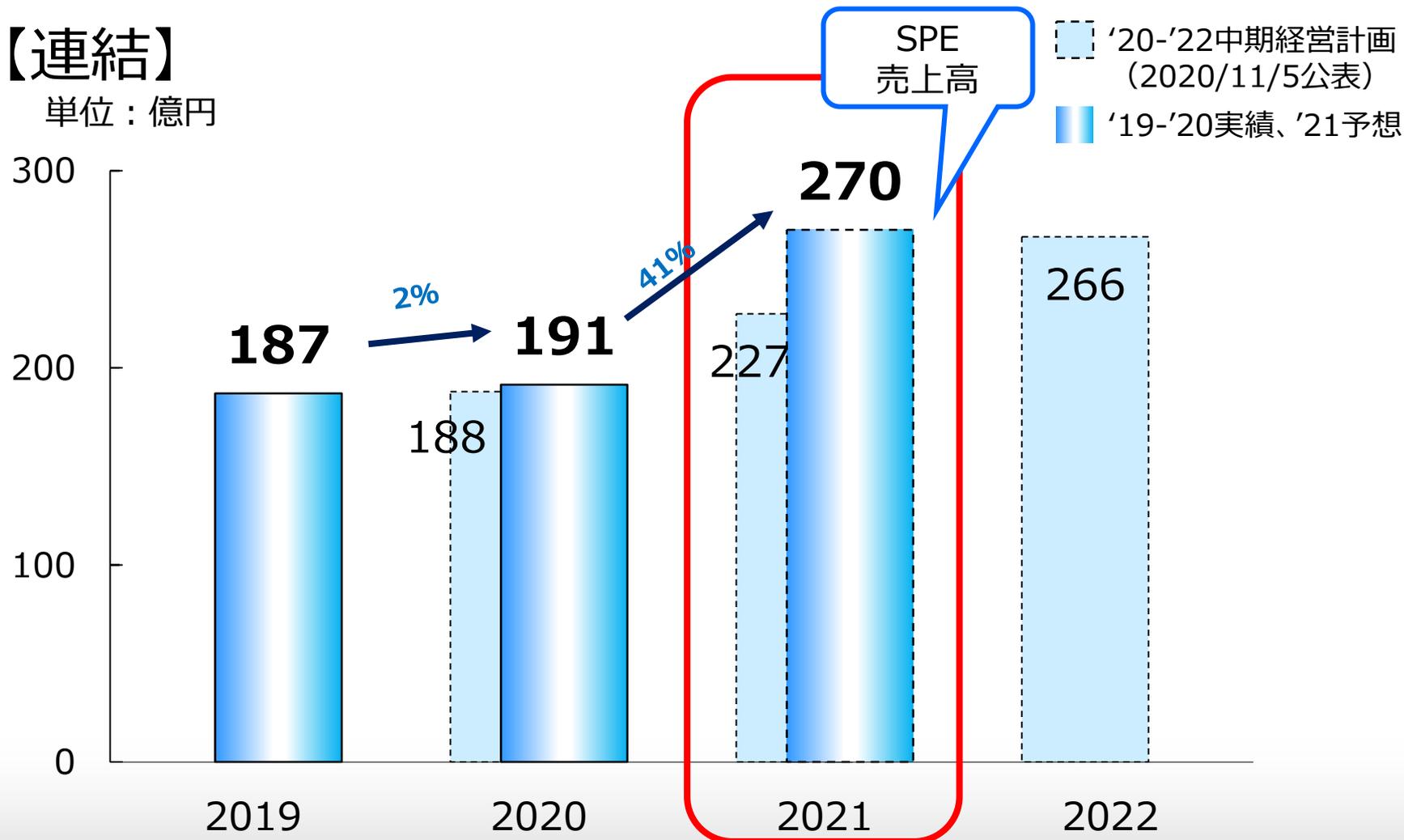
<展開>

- ・ロジック半導体をはじめ、多くの分野用途へ展開中
- ・新規上市、受注獲得
- ・試作評価から量産展開へ市場を牽引

グローバルニッチトップ製品を核としたSPEの拡大

【連結】

単位：億円

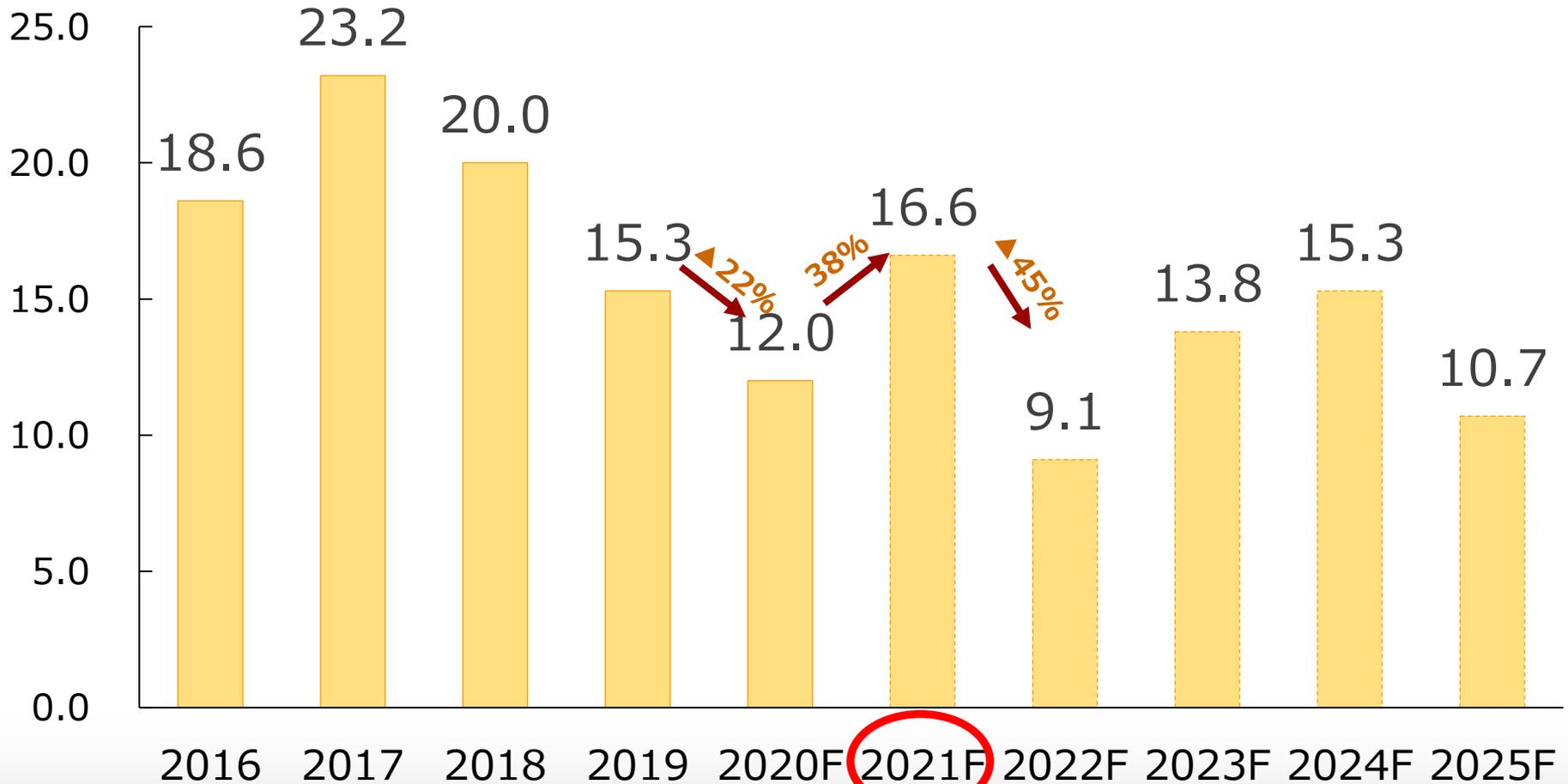


設備投資高予測

* 出典：DSCC 2021-7
当社にてグラフ作成

2019 – 2022CAGR : ▲15.9%

単位：10億US \$



当社の事業環境

同様に受注面からみると

- ✓ FPD前工程 大型LCDはTV、ITパネルの需要増により新規&増設投資計画が具体化、中小型OLEDは投資時期が流動的
- ✓ FPD後工程 大型、中小型とも投資継続見込み、特にモニタ用、車載用、miniLEDバックライトユニット用などの投資の伸びや、 μ LEDの市場拡大に期待

FPD新規製品事例



フレキシブルOLED向け真空焼成炉
(HV Series)

<特徴>

- ・業界初真空中でのPI焼成
- ・低発塵、昇華物の再析出、再付着の抑制
- ・従来(IR方式)比 電力、N₂ガス使用量 大幅削減
- ・標準焼成時間 大幅短縮

<展開>

- ・大手パネルメーカーR&D納入
- ・材料メーカーとの連携強化中
- ・フレキシブルOLED投資加速に期待



中型OLB
(TTO-H3000M)

<特徴>

- ・高精度
- ・高スループット
- ・幅広い適用パネルサイズと高精度技術の融合で幅広い顧客ニーズに対応

<展開>

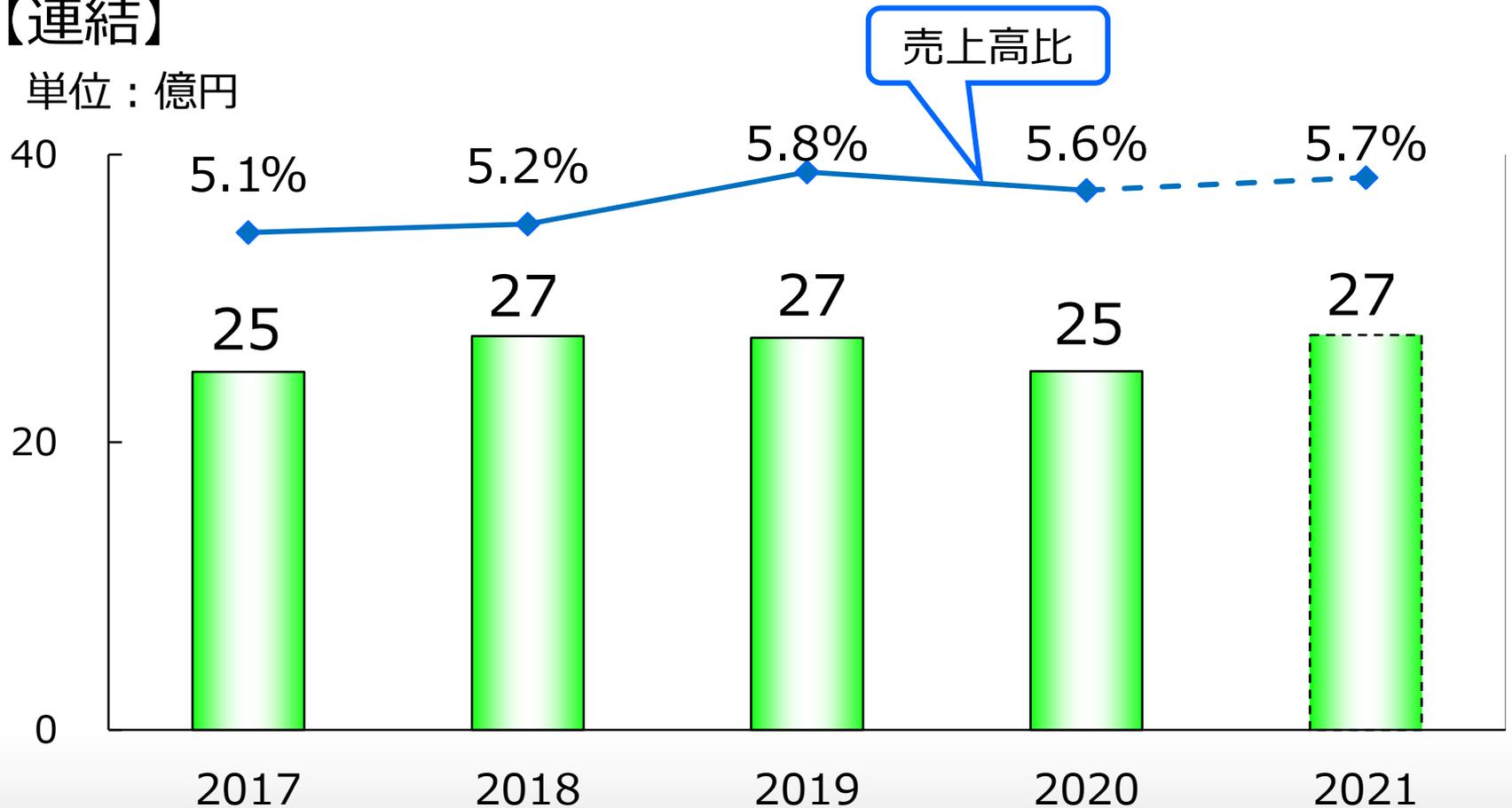
- ・独自技術搭載の新機種上市に向け、顧客評価注力中
- ・モニタ、車載市場でのシェア拡大を図る

研究開発費

SPE分野の開発加速

【連結】

単位：億円

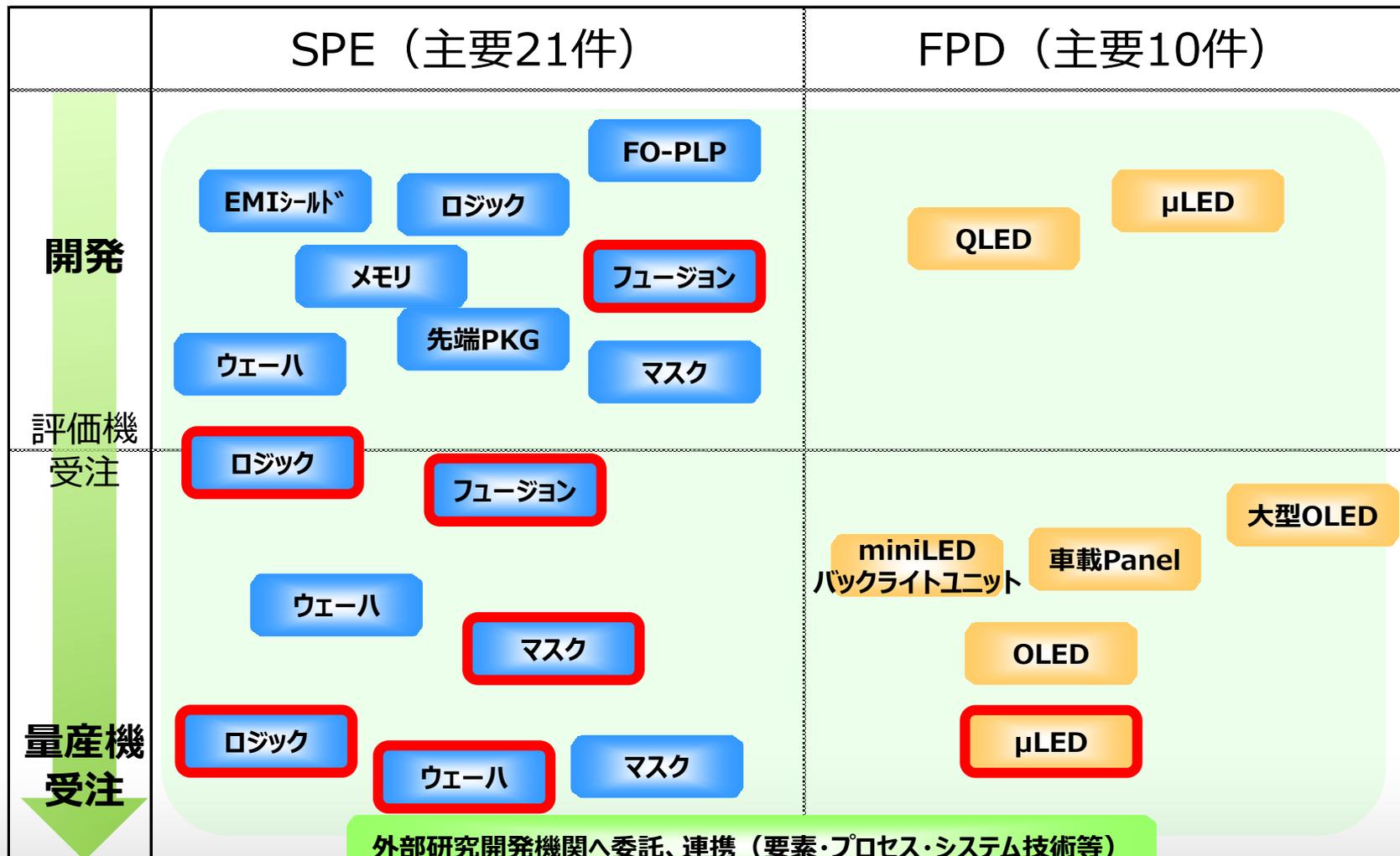


他社との連携 ①

- 装置メーカー、材料メーカー、デバイスメーカー、研究所や大学等と連携し、強い製品をより早く、速く開発
- 主な株主（株式会社 東芝、信越エンジニアリング株式会社、株式会社 ニューフレアテクノロジー）と連携
- 主要なテーマ計31件（前回23件）進行中
特に、ウェーハ、マスク、ロジック、フュージョン、 μ LEDが順調に進捗し、事業の拡大に寄与

他社との連携 ②

* 同じテーマ目つ進捗が同程度の複数案件は纏めて表示

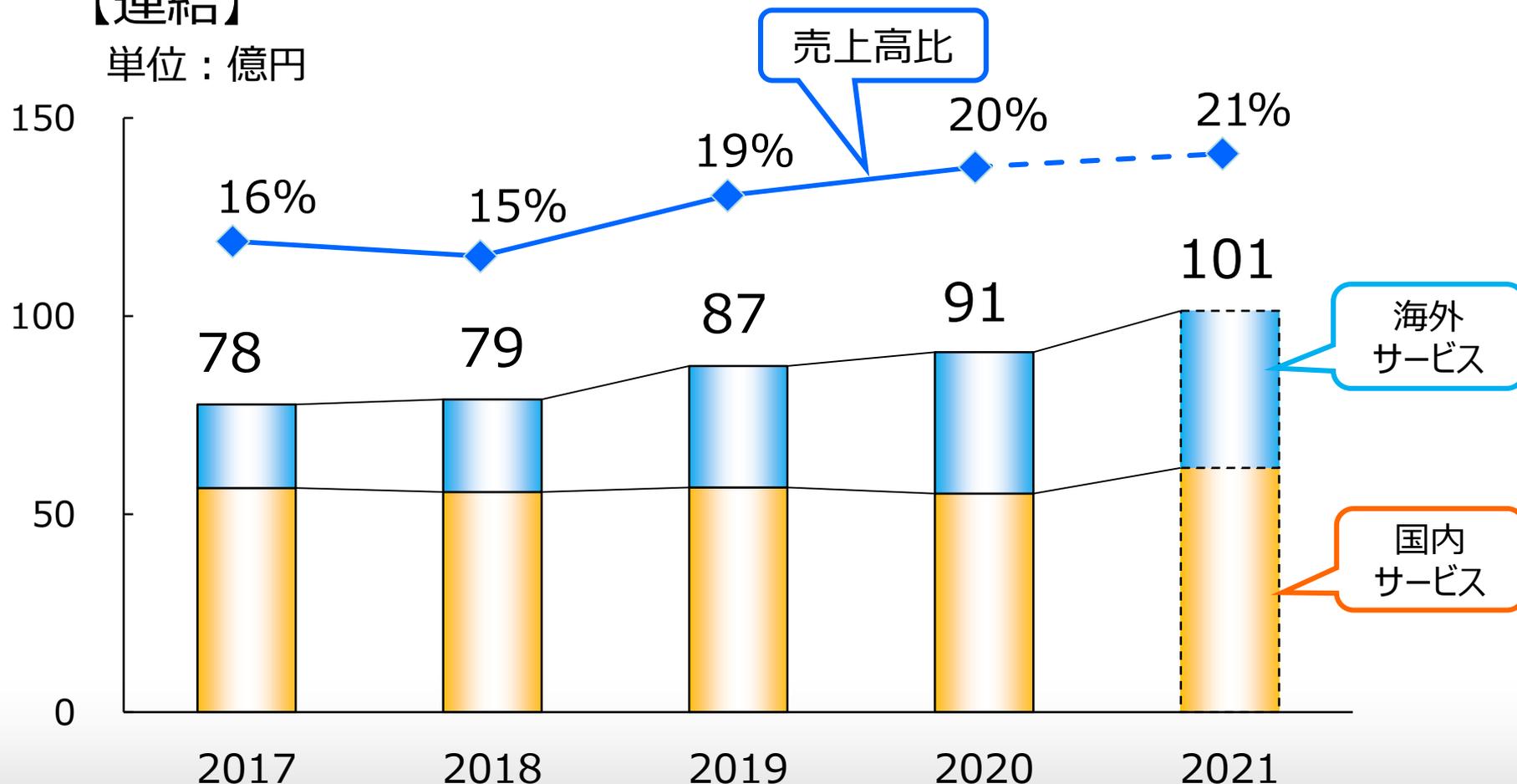


サービス事業売上高

中国市場でのサービス事業を強化
売上高比率目標 22年度23%

【連結】

単位：億円

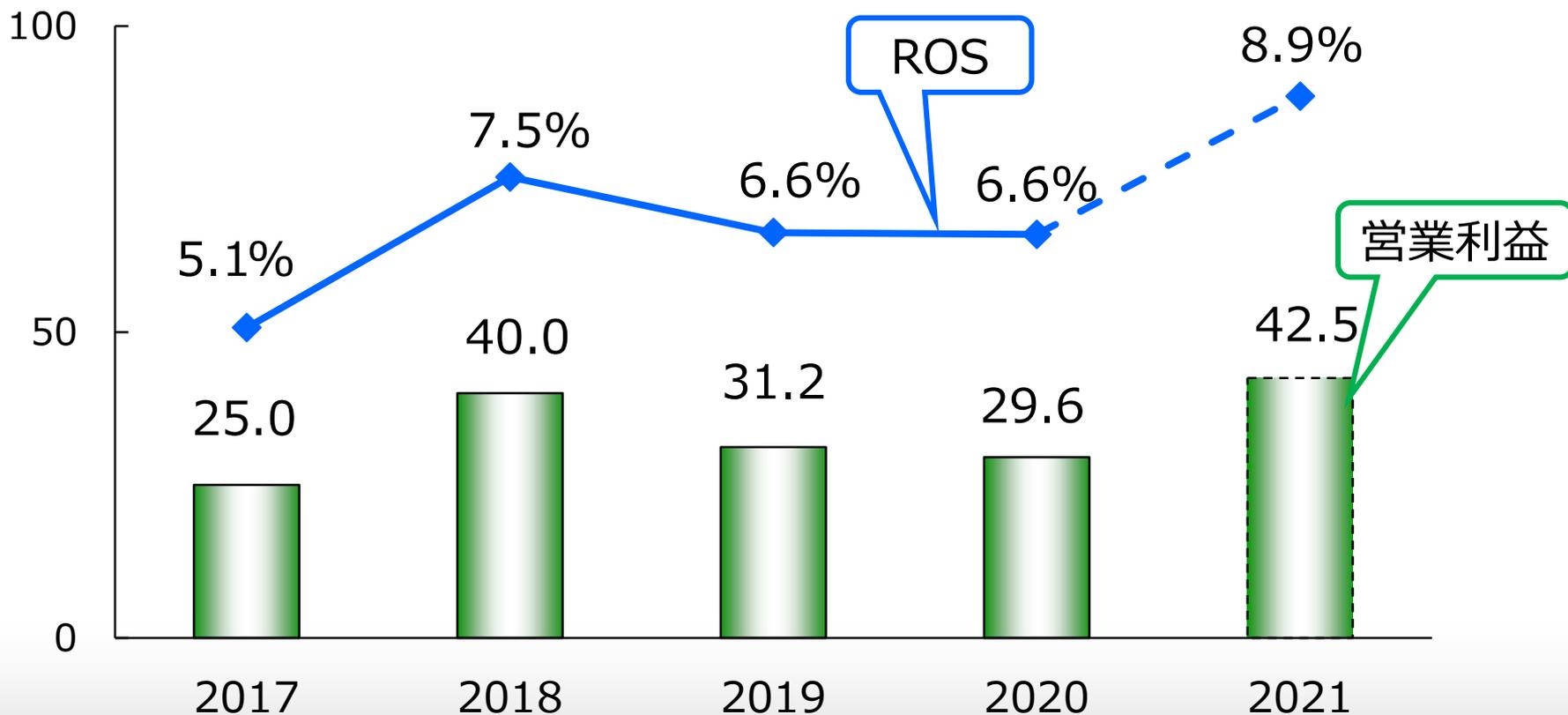


ROS改善

【連結】

単位：億円

SPE分野など高付加価値製品の拡大により、ROSを改善
目標22年度10%



製品

環境調和型製品の割合
 目標：対売上高85%以上

事業プロセス

事業所エネルギー使用量*1
 目標：対前年度1%削減

ゼロエミッション比率*2
 目標：0.5%以下

持続可能な社会ならびに
 人々の豊かな暮らしの
 実現に貢献できるよう
 ESGを重視した経営を
 行ってまいります



*1: 原単位当たり *2: 埋立物量／総廃棄物量

Smart Solutions & Services for Your Manufacturing

「Smart」「Solutions」「Services」の3つの「S」で
お客様のものづくりに貢献してまいります。

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があることをご了承願います。

END